

测试题

填空题 (2*20)

1. 表面组装技术是指：_____。
2. SMT 技术的优点有：_____。
3. 在印刷技术中钢网起到的作用是：_____。
4. SMT 一般线体设备布局是：_____。
5. SMT 表面组装单面锡膏工艺流程顺序：_____
_____。
6. 智能制造 SMT 技术能制造生活中的产品，列举五种以上：_____
_____。
7. 涂覆材料锡膏的重要特性：_____。
8. 对以下单位进行换算
 $30\Omega =$ _____ $m\Omega =$ _____ $K\Omega$ $5 \times 10^3 nH =$ _____ $\mu H =$ _____ mH
9. 英制转化为公制：
0402 的电子物料尺寸为：_____， 0201 电子物料尺寸：_____。
10. 电阻表面字符 6R45 电阻值：_____， 6m56 电阻值：_____。
11. 396 无铅焊料锡膏百分比比例分别是_____、_____、_____。
12. 印刷技术中常见的印刷缺陷有哪些：_____。
13. 表面组装元器件分类可分为：_____。
14. 常见的静电防护物品有：_____。
15. PLCC 中文全称：_____， BGA：_____。
16. 写出色环电阻：橙绿棕紫灰的阻值：_____。
17. SMT 中的 PCB 板的特点：_____。
18. 常用有铅锡膏的熔点：_____， 无铅锡膏的熔点：_____。
19. SMT 常见的生产片式电子元器件包装有：_____。
20. 金属模板（钢网）制造方法：_____。

二、简答题 (60)

1、表面组装技术的组成包含哪些？ (8)

2、DEK 全自动印刷机的内部结构包含哪些？并说明各部位的功能作用是什么？ (12)

3、 SMT 中使用的元器件有哪些要求？（8）

5、印刷技术中印刷参数有哪些？其中有可根据工艺文件调整的参数有那几个？（8）

4、SMT 中双面工艺有几种？分别是哪些？并详细写出当前最常见的工艺顺序。（12）

6 常见的制程缺陷分析方法鱼骨图法是从哪几个方面来分析制程中出现的缺陷？并使用鱼骨图试分析印刷技术中出现的少锡情况。（12）